# 技术创新需求调查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业信息** | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | | | 昆山市板明电子科技有限公司 | | | | 机构代码 | | 66683282-3 | |
| 区域 | | | 千灯 | | 联系人 | 鲍金霞 | | 电话 | | 18136756119 |
| 行业领域 | | | 电子信息 | | | | 产业领域 | | 电子信息 | |
| 经济规模 | | | 3000万 | | | | 人员规模 | | 24 | |
| **需求信息** | | | | | | | | | | |
| 需求名称 | | | | 高端印制电路板制程所用电子化学品。例如非蚀刻性铜表面粘附增强剂、填孔电镀系列产品、改良半加成法（MSAP）工艺用系列化学品等。 | | | | | | |
| 技术需求情况说明 | 技术需  求类别 | | | √技术研发（关键、核心技术）  □产品研发（产品升级、新产品研发）  □技术改造（设备、研发生产条件）  □技术配套（技术、产品等配套合作） | | | | | | |
| 技术  需求  简述 | | | 随着电子技术的飞速发展，相关电子产品不仅在体积上趋向小、薄、轻；而且在性能上趋向高速传输、多功能化、智能化。同时人类环境保护意识的提高，人类生产活动更加重视绿色生产。针对这一形势，相关的电子产品生产制程发生了重大变化，例如印制电路板的生产正在趋向能够形成更细电路图形并且更加环保的半加成法制程。生产制程的革命性变化，必然导致相关制程用电子化学品的革命性变化。这要求企业必须加快产品更新换代，以满足发展的需要。目前需要MSAP制程用关键电子化学品的产品生产技术。 | | | | | | |
|  | 技术  需求  详述 | | | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标） | | | | | | |
| 现有  基础  情况 | | | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等） | | | | | | |
| 产学研合作要求 | 简要  描述 | | | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求）  **苏州大学等研发水平较高并且仪器较为完备的的院校。** | | | | | | |
| 合作  方式 | | | □技术转让 □技术入股 √联合开发 √委托研发  √委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 | | | | | | |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融  □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购  □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 □其他 | | | | | | | | | |
| **管理信息** | | | | | | | | | | |
| 同意公开  需求信息 | | √是 □否  □部分公开(说明） | | | | | | | | |
| 同意接受  专家服务 | | □是  □否 | | | | | | | | |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 | | □是  □否 | | | | | | | | |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 | | □是，金额万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件）  □否  法人代表： 年 月 日 | | | | | | | | |